

Chip Vac

칩백

QUIET only 77 dBA

칩을 오픈탑 드럼으로 직접 회수하며,
움직이는 부품이 없는 구조로 설계되었습니다!

칩 백이란 무엇인가?

EXAIR의 칩 백(Chip Vac)은 건식 또는 습식 칩을 흡입하여 일반 오픈탑 드럼으로 직접 이송합니다. 칩 백은 머시닝센터, 선반, 절단기, 밀링기 및 기타 산업용 장비의 지그, 바닥 및 작업 표면에 쌓인 칩을 청소하는 데 사용됩니다. 강력한 흡입력을 제공하여 빠르고 효율적인 청소 작업이 가능합니다. EXAIR의 미니 칩 백 시스템(Mini Chip Vac System)은 소규모 작업을 위해 동일한 청소 성능을 제공합니다. 이 시스템은 5갤런 드럼과 작업에 필요한 모든 액세서리를 포함한 완전한 패키지로 제공됩니다.

왜 칩 백인가?

압축공기로 작동하는 칩 백(Chip Vac)은 칩 회수를 위해 특별히 설계된 산업용 진공 시스템입니다. 칩 백은 강력한 직접 흡입 방식을 통해 금속, 목재 또는 플라스틱 칩을 일반 오픈탑 드럼으로 직접 이송합니다. 또한 분진이 발생하는 작업에 사용할 수 있도록 필터 백이 기본 포함되어 있어 작업장 주변 공기를 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 일반적인 전기식 다목적 진공청소기는 산업 환경에서 사용하도록 설계되지 않았기 때문에 모터가 빠르게 마모되거나 임펠러가 막히는 문제가 발생할 수 있습니다. 반면 칩 백은 움직이는 부품이 전혀 없어 마모되거나 파손될 부품이 없으며, 이를 통해 긴 수명을 제공합니다. 또한 소음 수준은 일반 전기식 진공청소기의 약 절반 수준으로 매우 조용합니다. 칩 백 시스템에는 오픈탑 드럼에 장착할 수 있는 잠금 링 방식의 드럼 뚜껑이 포함됩니다. 칩 백은 1분 이내에 분리하여 다른 드럼으로 쉽게 옮길 수 있으므로 재활용을 위해 서로 다른 재료를 별도로 수거할 수 있습니다. 또한 모든 칩이 드럼으로 직접 회수되므로 진공청소기 탱크를 반복적으로 들어 올려 비워야 하는 번거로운 작업이 필요하지 않습니다.



칩 백은 CNC 가공 시 발생하는 마모성이 높은 스테인리스 칩을 빠르고 효율적으로 제거합니다.



110갤런 칩 백은 대규모 가공 작업에서 발생하는 칩을 처리할 수 있는 최대 용량의 회수 솔루션을 제공합니다.

Applications

- CNC 가공기
- 선반
- 절단기/밀링기
- 드릴링 장비
- 그라인더
- 라우터
- 사출성형기
- 흡착재 회수

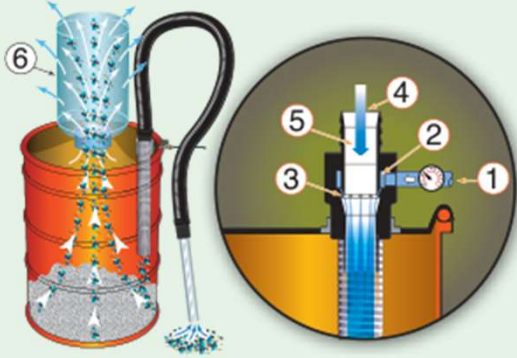
Advantages

- 구동 부품이 없어 유지보수 불필요
- 경제적인 운영 비용
- 막히거나 마모되는 모터 없음
- 전기 사용 불필요
- 칩을 드럼으로 직접 회수
- 강력한 직접 흡입 방식
- 다양한 액세서리 포함
- 전기식 진공청소기 대비 50% 낮은 소음 수준



미니 칩 백은 소규모 청소 작업에 적합한 간편하고 효율적인 솔루션입니다.

칩 백의 작동 원리



압축공기(일반적으로 80~100 PSIG, 5.5~6.9 BAR)는 인렛(1)을 통해 환형 플레넘 챔버(2)로 유입됩니다. 이후 압축공기는 방향성 노즐(3)을 통해 내부 목 부분(Throat)으로 분사됩니다. 이 고속 공기 분사는 흡입구(4)에 진공을 형성하여 자재를 흡입하고, 장치 내부(5)를 통과하면서 가속시킨 후 드럼 바닥으로 이송합니다. 공기 흐름은 드럼 뚜껑의 배기 포트를 통해 배출되며, 공기 중의 입자는 필터 백(6)에 포집 됩니다.

경고 : 가연성 분진에는 사용하지 마십시오.

칩 백 시스템은 양호한 상태의 오픈헤드(Open Head) 강철, 섬유(Fiber) 또는 플라스틱 드럼 (ANSI 규격 #MH2-2004)과 함께 사용할 수 있습니다. 자재 오염을 방지하기 위해 드럼 내부에 폴리 드럼 라이너(Poly Drum Liner)를 삽입하여 사용할 수 있습니다.



디럭스 및 프리미엄 칩 백 시스템에는 드럼 돌리(Drum Dolly)가 포함됩니다.

칩 백 성능

모델	공급 공기 압력 (BAR)	공기소모량 (리터/분)	Inlet 사이즈 (NPT)	소음도 (dBA)
110, 55, 30 갤런	5.5	1,132	3/8	77
5 갤런	5.5	934	3/8	



모델 6193 칩 백 시스템은 진공 호스, 칩 완드 및 플라스틱 툴 세트를 포함합니다.



모델 6193-5 미니 칩 백 시스템은 진공 호스, 5갤런 드럼, 칩 완드 및 플라스틱 툴 세트를 포함합니다.



프리미엄 칩 백 시스템은 드럼, 드럼 돌리, 정전기 방지 호스, 초강력 알루미늄 툴 세트, 툴 홀더, 압축공기 호스 및 퀵 커넥트 피팅을 포함합니다. (사진: 모델 6393)

칩 백 모델 정리

모델 No.	설명
6193	55갤런 칩 백 시스템은 칩 백, 레버 잠금식 드럼 뚜껑, 차단 밸브, 필터 백, 10피트(3m) 플렉시블 진공 호스(내경 1-1/2인치/38mm), 칩 완드, 연장 완드 2개, 틈새용 툴(Crevice Tool), 브러시 및 스키머 툴을 포함합니다. (드럼 별매)
6193-30	30갤런 칩 백 시스템 - 모델 6193과 동일한 구성으로 30갤런 드럼에 사용 가능합니다. (드럼 별매)
6193-5	5갤런 미니 칩 백 시스템은 칩 백(3/8 NPT), 차단 밸브, 필터 백, 뚜껑 및 잠금 링이 포함된 5갤런 용기, 10피트(3m) 플렉시블 진공 호스(내경 1-1/2인치/38mm), 알루미늄 칩 완드, 연장 완드 2개, 틈새용 툴, 브러시 및 스키머 툴을 포함합니다.
6293	55갤런 디럭스 칩 백 시스템 - 모델 6193과 동일한 구성에 드럼 돌리와 툴 홀더가 추가됩니다. (드럼 별매)
9293-30	30갤런 디럭스 칩 백 시스템 - 모델 6293과 동일한 구성으로 30갤런 드럼에 사용 가능합니다. (드럼 별매)
6293-5	5갤런 디럭스 미니 칩 백 시스템 - 모델 6193-5와 동일한 구성에 드럼 돌리가 추가됩니다.
6393	55갤런 프리미엄 칩 백 시스템 - 모델 6193과 동일한 구성에 55갤런 드럼, 드럼 돌리, 정전기 방지 호스, 초강력 알루미늄 툴 세트, 20피트(6.1m) 압축공기 호스, 툴 홀더 및 퀵 커넥트 피팅이 추가됩니다.
6393-30	30갤런 프리미엄 칩 백 시스템 - 모델 6393과 동일한 구성으로 30갤런 드럼이 포함됩니다.
6393-110	110갤런 프리미엄 칩 백 시스템 - 모델 6393과 동일한 구성으로 110갤런 드럼이 포함됩니다.
6093	칩 백 단품 - 상기 30갤런~110갤런 시스템에 포함되는 본체입니다.
6093-5	미니 칩 백 단품 - 6193-5 및 6293-5 5갤런 시스템에 포함되는 본체입니다.

액세서리

모델 No.	설명	모델 No.	설명
6804	교체용 필터 백	9041-5	5갤런 드럼 돌리
901176	마그네틱 툴 홀더	9041-30	30갤런 드럼 돌리
901071	초강력 알루미늄 툴 세트 및 툴 홀더	9041	55갤런 드럼 돌리
6569-20	20피트(6.1m) 플렉시블 진공 호스 (내경 1-1/2인치 / 38mm)	9041-110	110갤런 드럼 돌리